

三次元半導体用の先塗布型層間充填材料

河瀬 康弘*, 桐谷 秀紀**

Pre-Applied Inter Chip Fill for 3D-IC

Yasuhiro KAWASE* and Hideki KIRITANI**

* 三菱化学株式会社開発研究所 (〒 806-0004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石 1-1)

** 三菱化学株式会社電子デバイスキミカルズ事業部 (〒 100-8251 東京都千代田区丸の内 1-1-1)

* R&D Center, Mitsubishi Chemical Corporation (1-1, Kurosakishiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu, Fukuoka 806-0004)

** Electronic Device Chemicals Department, Mitsubishi Chemical Corporation (1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8251)